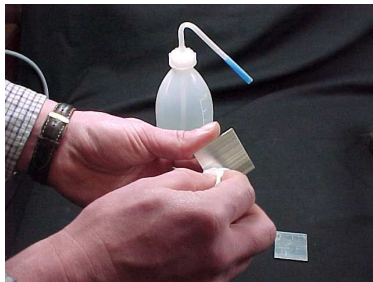


Verarbeitungshinweise zum S-Bond[®] - Weichaktivlot

**-Schwermetallfrei, keine Flussmittel, RoHS-konform-
-Löten vielfältigste Metalle, Leichtmetalle, Komposite und Keramiken-**

Fragen? Bitte anrufen unter +49 2401 607 2866. Vielen Dank.

1. Säubern und trocknen Sie die zu fügenden Oberflächen. Die Oberflächen müssen frei von Rost, Fett und Öl sein.



Legen Sie ein Gewicht von mind. 1 kg bereit.

2. Heizplatte vorheizen. Bauteile auf Heizplatte legen und aufheizen.



3. Bei einer Bauteiltemperatur von 230-250°C bei Verwendung von S-Bond[®] 220 bzw. 420-450°C bei Verwendung von S-Bond[®] 400 muß je ein Stück Lot auf die Fügeflächen beider Bauteile abgeschmolzen werden.



4. Lassen Sie das Lot jeweils vollständig aufschmelzen.

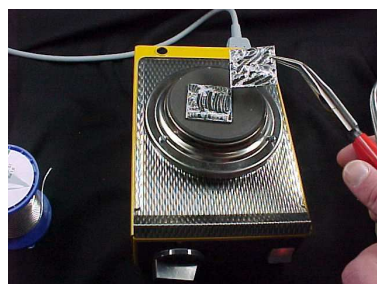


5. Halten Sie alle Fügepartner (Bauteile) während des gesamten Prozesses auf Temperatur.
6. Die entstandenen Oxidschichten müssen nun mechanisch mit einer vorgeheizten Bürste oder Ultraschall-Impuls durch den S-Bonder mini aufgerissen werden. Nur auf diese Weise kann danach das S-Bond[®]-Lot unter Druck verteilt werden. (s. auch schematische Darstellung)



HINWEIS: Die Verwendung von S-Bond[®] erfolgt ohne Zusatz eines Flußmittels.

7. Beide Bauteile müssen auf der Fügefläche vollständig mit Lot bedeckt werden.

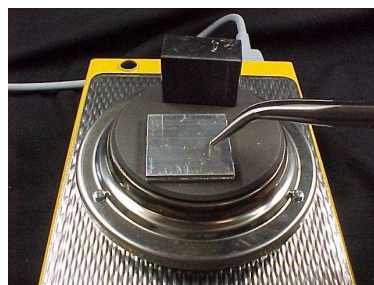


8. Wenn Sie beide Fügepartner benetzt haben und das S-Bond[®] noch geschmolzen ist, sollten Sie die Bauteile unter Druck relativ zueinander bewegen (auf diese Weise

werden die erneut entstandenen Oxidschichten wieder aufgerissen) und nun zueinander positionieren. (s. auch schematische Darstellung)



9. Legen Sie nun ein Gewicht auf den oberen Fügepartner.



10. Lassen Sie die Fügeteile während der Abkühlung ruhen. Das Gewicht können Sie dann nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur entfernen.

Zusammenfassende schematische Darstellung:

